

# 2008年3月期決算補足資料 (2008年5月)



**Challenge 30**

誇りあるTOWAブランド確立に向けて!

**2008年3月期 決算会社説明会**

2008年5月

**TOWA株式会社**

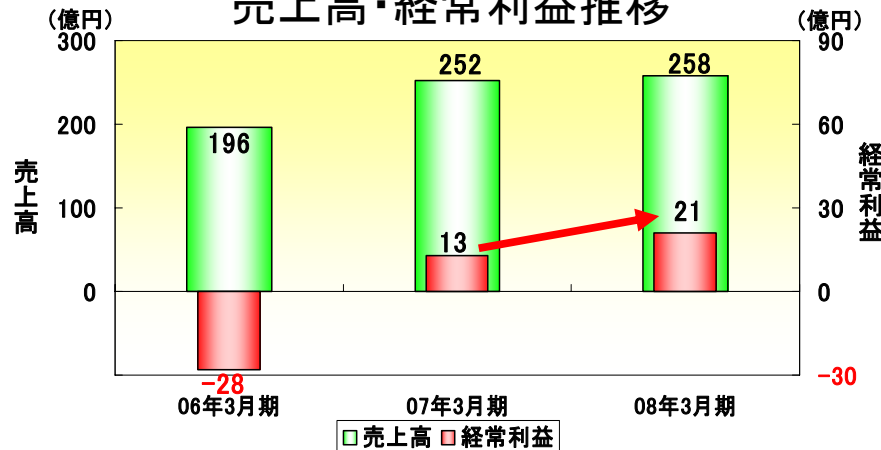
**2008年3月期業績概要(連結)**

(百万円)

	07年3月期実績	08年3月期実績	対前期比
売上高	25,159	25,753	+594 (+2.4%)
売上総利益	5,705	7,533	+1,828 (+32.0%)
《 同 率 》	《22.7%》	《29.3%》	《+6.6ポイント》
営業利益	1,224	2,381	+1,157 (+94.5%)
経常利益	1,289	2,125	+836 (+64.8%)
当期純利益	1,038	2,118	+1,080 (+104.0%)

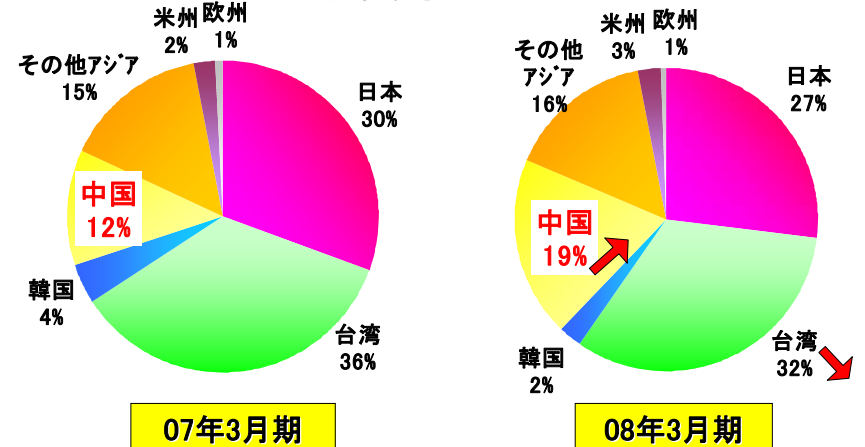
・売上は微増だが、利益は大幅増を達成

**売上高・経常利益推移**



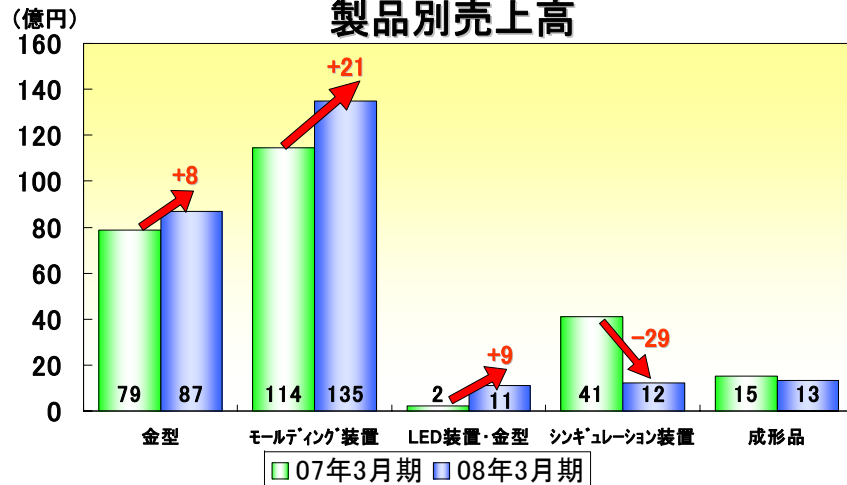
・台湾アSEMBリハウスの中国進出が本格化

**地域別シェア**



- ・コア技術である金型・モルディング装置が好調
- ・LEDの量産化の立ち上がり遅れ
- ・シンギュレーション装置の売上減

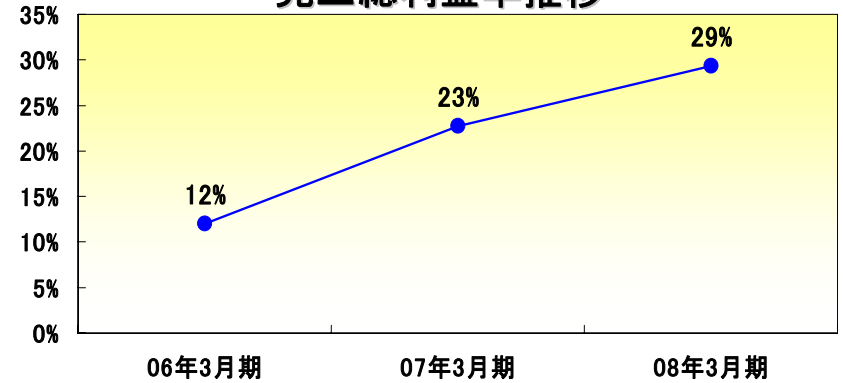
製品別売上高



売上総利益率の大幅アップ

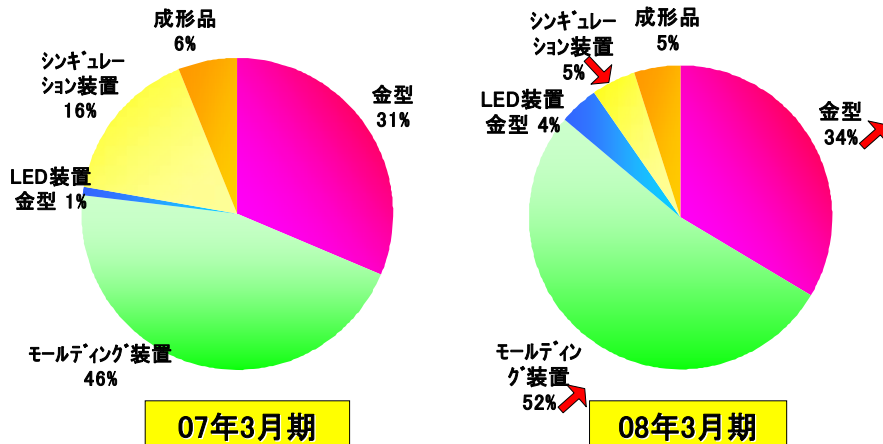
- ・原価低減活動効果
- ・製品ミックスの改善

売上総利益率推移



- ・利益率が高い金型、モルディング装置の売上増加
- ・採算性の低いシンギュレーションは売上減少

製品別シェア

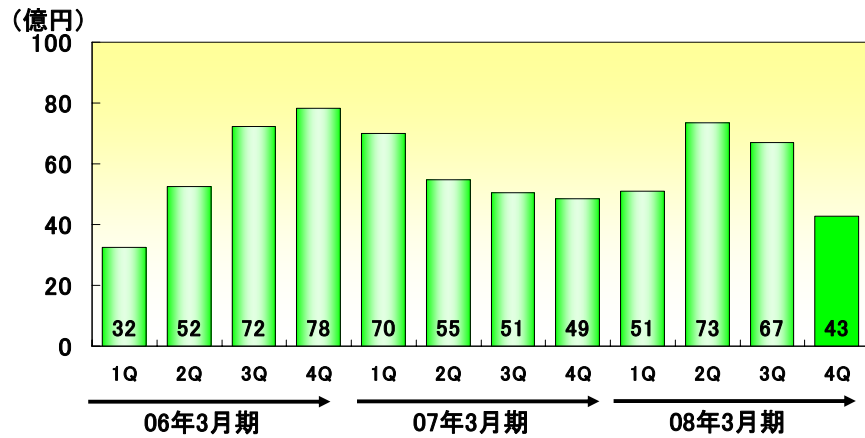


2009年3月期計画(連結)

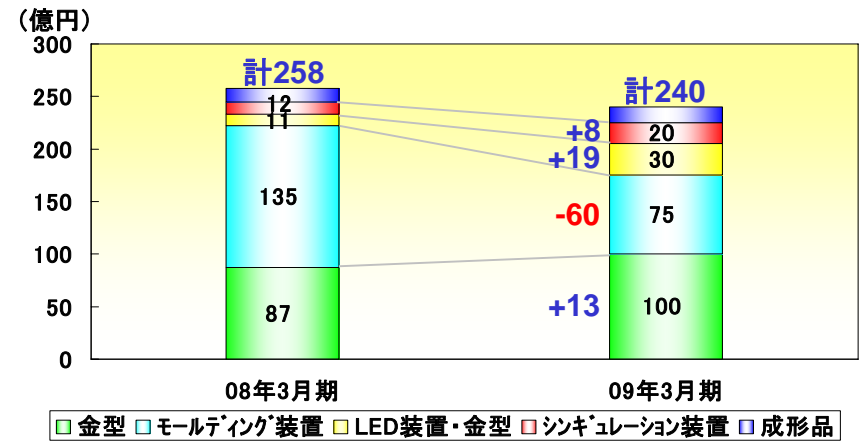
(百万円)

	08年3月期実績	09年3月期計画	対前期比
売上高	25,753	24,000	-1,753 (-6.8%)
営業利益	2,381	2,500	+119 (+5.0%)
経常利益	2,125	2,400	+275 (+12.9%)
当期純利益	2,118	2,200	+82 (+3.8%)
配当	10円	12円	+2円

## 四半期別受注高推移



## 売上高内訳

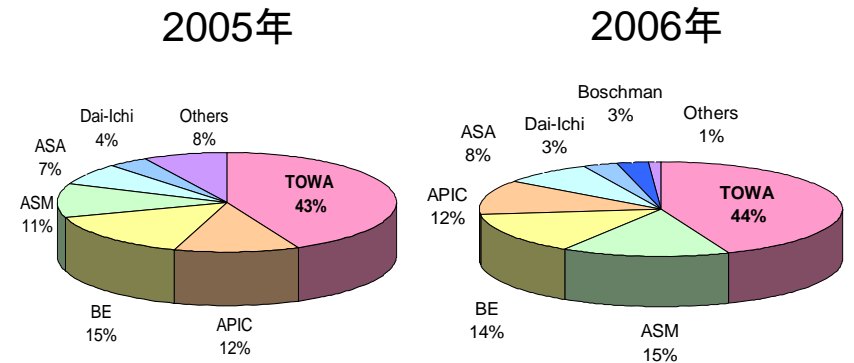


## 2009年3月期 重点戦略

半導体モルディング分野でのダントツシェアを確保

- 金型の生産キャパアップ、リポート金型の拡販
- コンプレッションモールドの量産機市場投入
- LED量産機の市場投入
- シンギュレーション新装置の市場投入
- 品質の向上
- 内部統制とERPグループ展開

## 全世界モルディング装置市場シェア



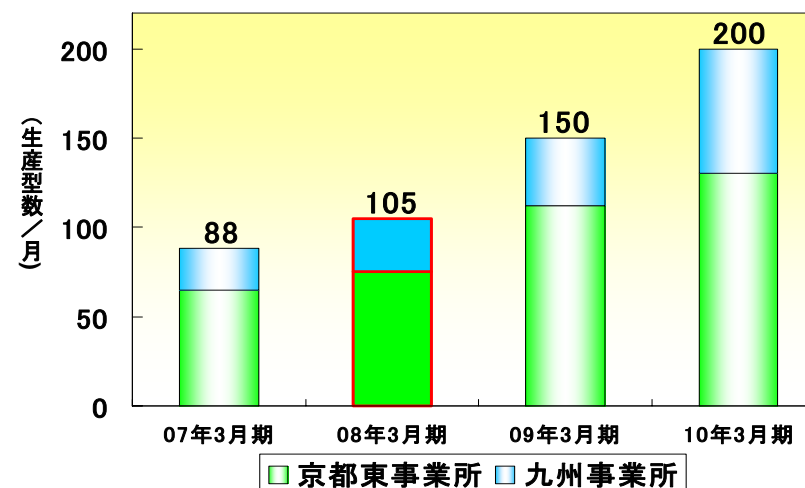
## 九州事業所概要



総敷地面積 11,000㎡  
工場床面積 2,700㎡

13

## 金型の生産能力強化



14

## TOWAM工場の生産能力拡大



&lt;増築前&gt;



&lt;増築後&gt;

(床面積) 4,459㎡

(組立能力)

モールド装置 13台/月  
シンキュレーション装置 4台/月

7,431㎡

22台/月  
8台/月

15

## コンプレッションモールド量産機の投入

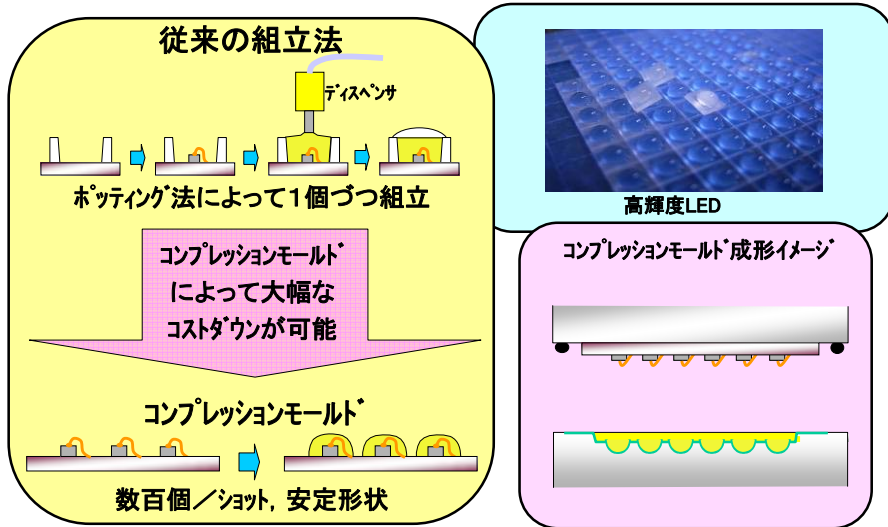
- 最先端パッケージ(多段スタック、極薄)向けとして開発
- 従来パッケージにもコスト削減効果大
  - ・基板の大型化対応
  - ・金の使用量削減  
金線のワイヤ径25μ → 16μ 金使用量60%減



コンプレッションモールドの量産機を市場投入

16

## コンプレッションモールドを適用した高輝度LED生産法



## LED装置ラインナップ

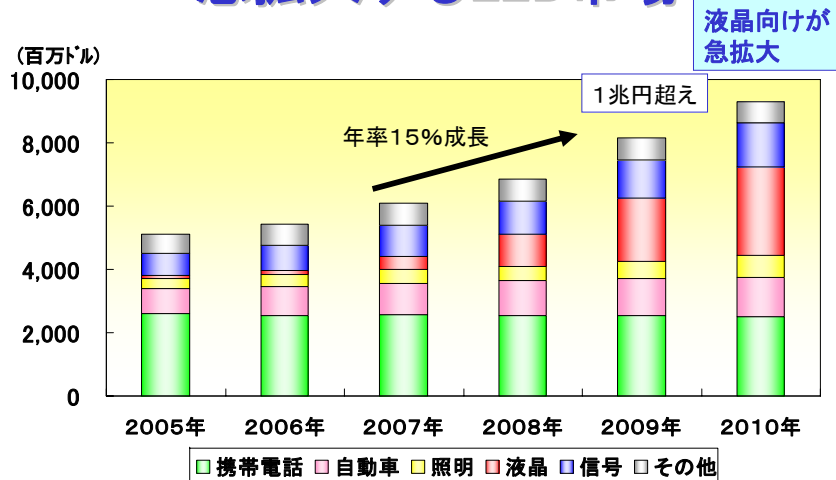


FFT1030W

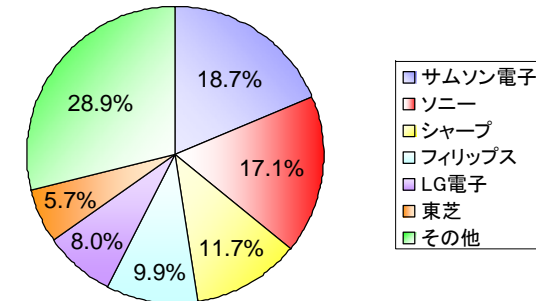


FFT1005  
(マニュアル装置)

## 急拡大するLED市場



## 液晶テレビ市場動向



米ディスプレイサーチ調査 2007年出荷額ベース

各液晶テレビメーカーが、バックライトのCCFL(冷陰極管)からLEDへの切り替え開発・量産化を本格化。



## 品質の向上

- ▶ 全社員を対象としたモノづくり研修の実施
- ▶ 品質工学(タグチメソッド等)を駆使  
(目標)クレーム1/3削減



21

## 内部統制とERPグループ展開

### ＜SAP導入・会計基準＞

- ERPの導入、タイムリーな経営資料
- SAPにシステムを統一、会計基準の統一  
(第一ステージ・08年4月)

TOWA-HQ、TOWATEC

(第二ステージ・09年4月)

TOWA-SZO、TOWAM

(第三ステージ・10年4月)

TOWA-APなど販売子会社

22

## 2008年度 全社スローガン

# 飛躍!!

# 輝ける明日のTOWAへ

## — 品質は我等の誇り —

**Take Off!! Make the Future Brighter for TOWA!!**

- Achieve the Best Quality -



23

## この資料についてのお問い合わせ

**TOWA株式会社 経営企画室**

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

Fax: 075-692-0270

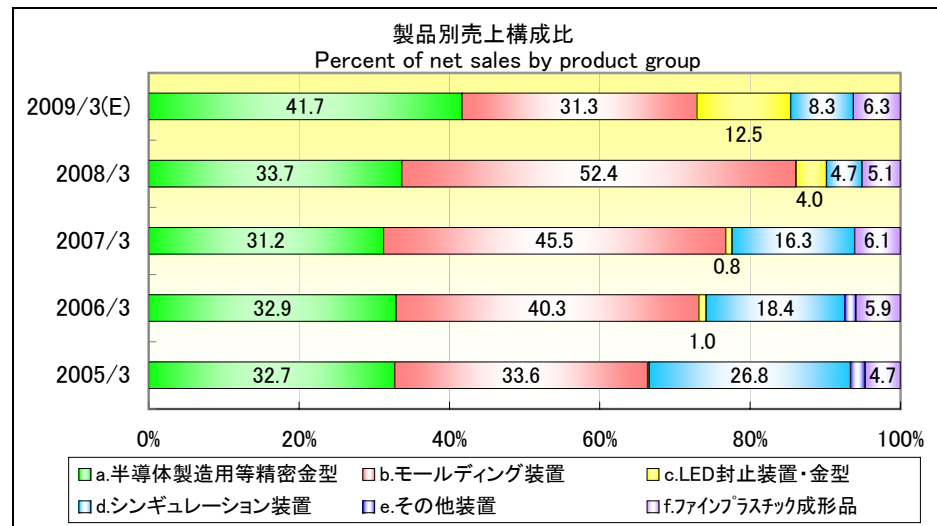
[http://www.towajapan.co.jp/contact/i\\_ir/index.htm](http://www.towajapan.co.jp/contact/i_ir/index.htm)

本資料おける予想は、現在入手可能な情報から得られた情報に基づいており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。

実際の業績は、様々な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おください。

24

I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



決算期		2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3(E)
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions					
売上高	①Net sales	24,111	19,641	25,159	25,753	24,000
営業利益	Operating income	402	-3,012	1,224	2,381	2,500
経常利益	Ordinary income	326	-2,778	1,289	2,125	2,400
当期純利益	Net income	146	-5,923	1,038	2,118	2,200
総資産	Total assets	38,343	36,602	34,925	34,360	—
純資産	Net assets	15,998	13,003	14,941	16,394	—
1株当たり指標	Per share data					
1株当たり当期純利益	Net income per share	7.04	-275.58	41.59	84.70	87.95
諸指標	Data					
自己資本当期純利益率	Return on equity	0.9	-40.8	7.4	13.5	12.7
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	0.9	-7.4	3.6	6.1	—
売上高営業利益率	②Operating income to net sales	1.7	-15.3	4.9	9.2	10.4
自己資本比率	Equity ratio	41.7	35.5	42.8	47.7	—

(単位: 百万円/¥Millions)

	2007/9	2008/9(E)
売上高	11,460	10,000
営業利益	803	400
経常利益	824	300
当期純利益	885	200
総資産	33,594	—
純資産	15,971	—
1株当たり当期純利益	35.41	8.00
自己資本当期純利益率	5.7	1.2
総資産経常利益率	2.4	—
売上高営業利益率	7.0	4.0
自己資本比率	47.5	—

増減率	Percent change	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3(E)
決算期						
売上高	Net sales	33.2	-18.5	28.1	2.4	-6.8
営業利益	Operating income	-10.5	—	—	94.5	5.0
経常利益	Ordinary income	-2.7	—	—	64.8	12.9
当期純利益	Net income	—	—	—	104.0	3.9

	2007/9	2008/9(E)
売上高	-7.2	-12.7
営業利益	43.6	-50.2
経常利益	56.0	-63.6
当期純利益	121.5	-77.4

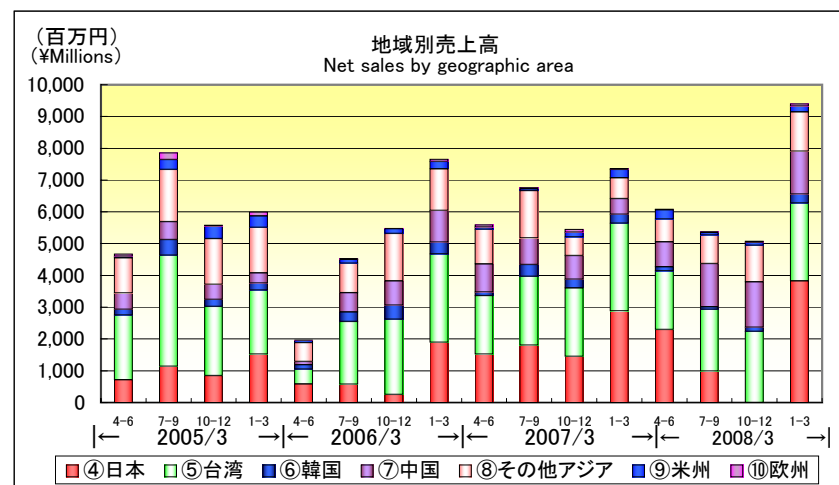
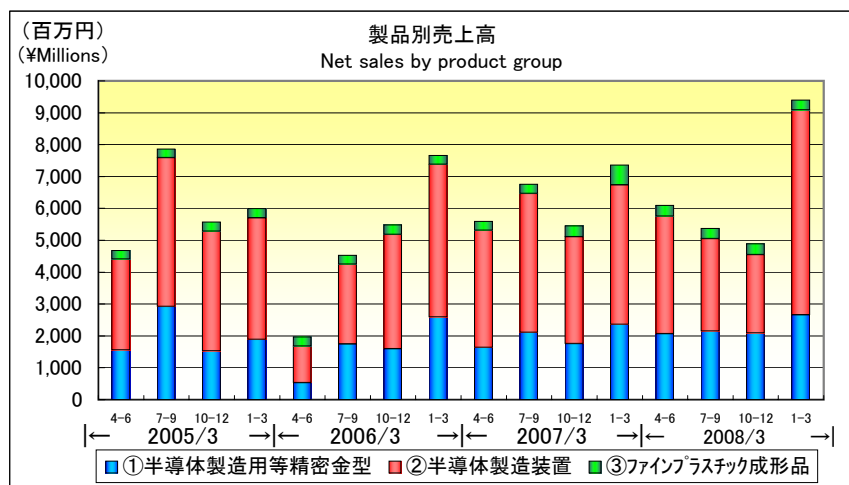
※a.Precision molds  
d.Singuration parts and systems

b.Semiconductor plastic encapsulation systems  
e.Others

c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED  
f.Engineering plastic molded products



II. 四半期売上動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



※ 従来半導体製造用等精密金型に分類していましたがシンギュレーション金型部品を半導体製造装置に含めて表示しております。

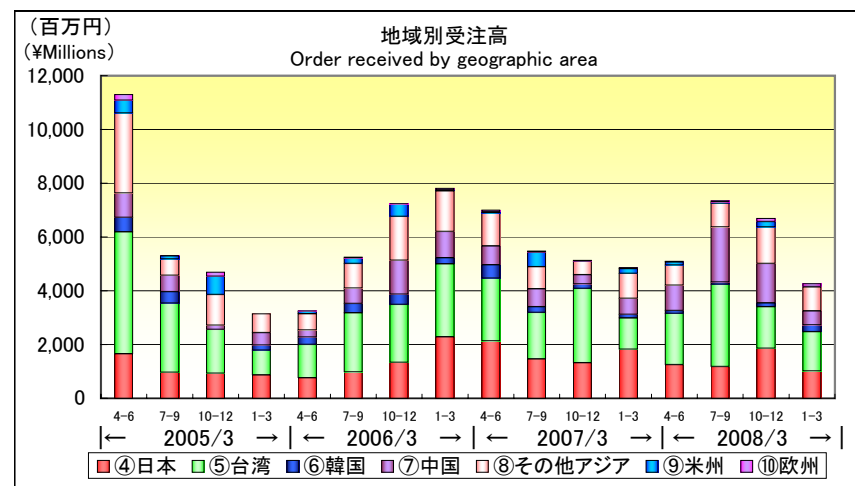
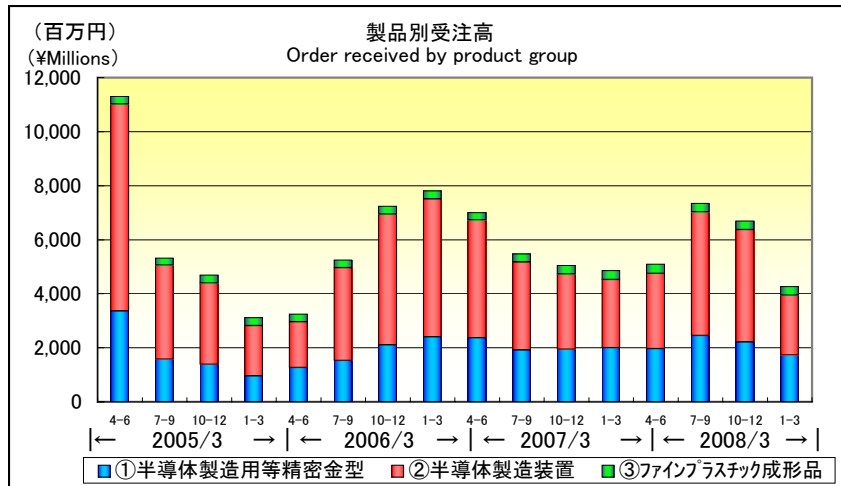
製品別売上高 Net sales by product group

決算期	2005/3					2006/3					2007/3					2008/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	4,678	7,859	5,578	5,994	24,111	1,970	4,528	5,483	7,659	19,641	5,589	6,756	5,451	7,362	25,159	6,090	5,369	4,894	9,398	25,753
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	1,559	2,924	1,523	1,885	7,891	531	1,751	1,598	2,588	6,462	1,633	2,112	1,755	2,359	7,861	2,073	2,149	2,087	2,660	8,970
半導体製造装置 ② Semiconductor manufacturing equipment	2,845	4,667	3,761	3,815	15,088	1,144	2,494	3,581	4,788	12,017	3,680	4,351	3,355	4,379	15,766	3,681	2,901	2,461	6,425	15,469
ファインプラスチック成形品 ③ Engineering plastic molded products	274	268	293	293	1,129	294	281	302	282	1,161	275	293	341	622	1,531	336	319	345	312	1,313
月平均	1,559	2,620	1,859	1,998	2,009	657	1,509	1,828	2,553	1,637	1,863	2,252	1,817	2,454	2,097	2,030	1,789	1,631	3,132	2,146

地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期	2005/3					2006/3					2007/3					2008/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	4,678	7,859	5,578	5,994	24,111	1,970	4,528	5,483	7,659	19,641	5,589	6,756	5,451	7,362	25,159	6,090	5,369	4,894	9,398	25,753
日本 ④ Japan	711	1,139	845	1,524	4,220	581	571	254	1,896	3,302	1,519	1,805	1,447	2,880	7,653	2,300	983	-186	3,826	6,924
アジア太平洋 Asia pacific	3,839	6,199	4,315	3,983	18,336	1,302	3,814	5,069	5,458	15,644	3,927	4,858	3,762	4,192	16,742	3,477	4,283	4,941	5,318	18,020
(内 台湾) ⑤ Taiwan	2,040	3,498	2,177	2,012	9,728	463	1,976	2,362	2,779	7,582	1,842	2,165	2,157	2,761	8,927	1,841	1,944	2,237	2,443	8,465
(内 韓国) ⑥ Korea	181	485	224	222	1,113	143	300	450	368	1,262	117	366	272	283	1,040	131	89	130	287	639
(内 中国) ⑦ China	514	567	470	321	1,873	97	604	762	1,001	2,465	884	840	751	493	2,969	781	1,350	1,425	1,351	4,908
(内 その他アジア) ⑧ Other asia	1,102	1,647	1,443	1,426	5,620	597	933	1,494	1,309	4,333	1,084	1,486	580	654	3,805	722	899	1,148	1,235	4,006
米州 ⑨ America	52	312	394	366	1,125	76	120	147	233	578	74	64	146	258	543	284	83	97	188	654
欧州 ⑩ Europe	75	208	23	120	428	9	22	12	70	115	66	28	94	31	220	28	19	41	65	154

Ⅲ. 四半期受注動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



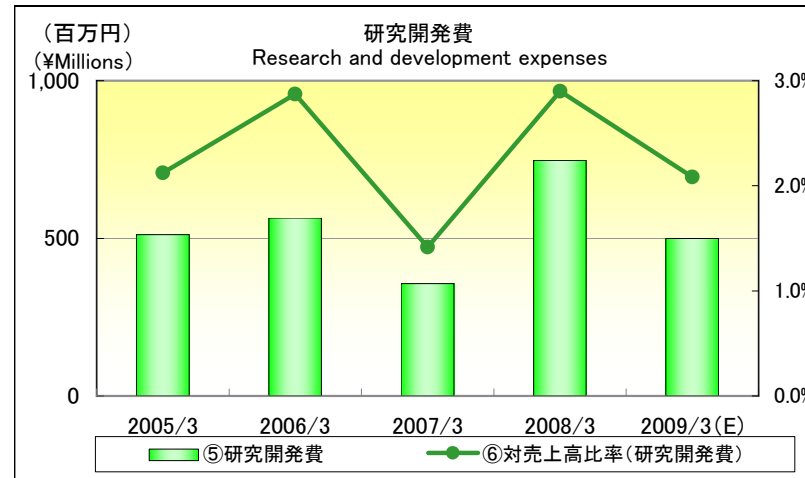
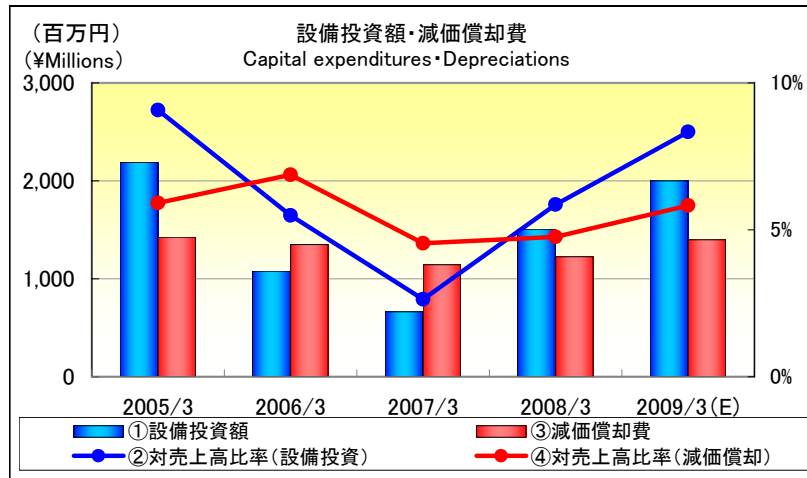
※ 従来半導体製造用等精密金型に分類していましたがシンギュレーション金型部品を半導体製造装置に含めて表示しております。  
製品別受注高 Order received by product group

決算期	2005/3					2006/3					2007/3					2008/3					
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	
受注高合計 Total order received	11,299	5,318	4,696	3,121	24,435	3,249	5,247	7,237	7,814	23,547	7,004	5,475	5,051	4,857	22,388	5,097	7,345	6,697	4,268	23,410	
半導体製造用等精密金型																					
① Precision molds	3,367	1,570	1,384	960	7,282	1,273	1,527	2,110	2,406	7,318	2,369	1,917	1,938	2,006	8,232	1,964	2,453	2,219	1,725	8,362	
半導体製造装置																					
② Semiconductor manufacturing equipment	7,653	3,485	3,016	1,863	16,018	1,685	3,442	4,828	5,110	15,068	4,359	3,254	2,783	2,516	12,915	2,790	4,573	4,149	2,225	13,739	
ファインプラスチック成形品																					
③ Engineering plastic molded products	278	263	295	297	1,134	290	276	297	295	1,161	275	302	328	333	1,241	342	318	328	318	1,308	
月平均	3,766	1,773	1,565	1,040	2,036	1,083	1,749	2,412	2,605	1,962	2,335	1,825	1,684	1,619	1,866	1,699	2,448	2,232	1,422	1,951	

地域別受注高 Order received by geographic area

決算期	2005/3					2006/3					2007/3					2008/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	11,299	5,318	4,696	3,121	24,435	3,249	5,247	7,237	7,814	23,547	7,004	5,475	5,051	4,857	22,388	5,097	7,345	6,697	4,268	23,410
日本 ④ Japan	1,650	969	927	871	4,418	763	982	1,331	2,283	5,361	2,133	1,465	1,322	1,821	6,742	1,249	1,176	1,854	1,015	5,295
アジア太平洋 Asia pacific	8,958	4,215	2,928	417	18,378	2,384	4,032	5,433	5,427	17,277	4,760	3,432	3,770	2,826	14,788	3,706	6,078	4,515	3,125	17,425
(内 台湾) ⑤ Taiwan	4,545	2,570	1,630	913	9,659	1,242	2,199	2,155	2,717	8,314	2,337	1,724	2,767	1,164	7,994	1,909	3,063	1,548	1,459	7,981
(内 韓国) ⑥ Korea	529	421		192	1,143	267	341	389	229	1,227	498	214	158	131	1,002	108	81	143	253	586
(内 中国) ⑦ China	908	609	160	463	2,142	267	578	1,251	975	3,072	698	671	345	600	2,316	935	2,054	1,471	525	4,986
(内 その他アジア) ⑧ Other asia	2,974	613	1,138	707	5,433	606	915	1,636	1,505	4,663	1,226	821	498	929	3,475	753	878	1,351	887	3,871
米州 ⑨ America	482	120	680	-16	1,266	92	203	464	38	799	49	528	-78	177	677	113	41	202	17	375
欧州 ⑩ Europe	208	13	160	-10	372	8	30	7	64	109	60	50	36	32	179	28	50	124	110	313

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結) (Consolidated)		2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3(E)
キャッシュフロー	Cash flows					
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	-2,571	-166	1,894	2,587	—
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-1,883	-1,548	252	-1,083	—
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	3,947	2,232	-2,203	-1,947	—
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents at	2,959	3,588	3,542	3,351	—
設備投資額	①Capital expenditures	2,189	1,079	663	1,508	2,000
対売上比率	②Ratio of sales	9.08	5.49	2.64	5.86	8.33
減価償却費	③Depreciations	1,425	1,349	1,144	1,227	1,400
対売上比率	④Ratio of sales	5.91	6.87	4.55	4.76	5.83
研究開発費	⑤Research and development expenses	512	564	356	747	500
対売上比率	⑥Ratio of sales	2.13	2.87	1.42	2.90	2.08

(単位: 百万円/¥Millions)		2007/9	2008/9(E)
		1,293	—
		-623	—
		-1,236	—
		2,970	—
		534	800
		4.66	8.00
		590	650
		5.15	6.50
		400	250
		3.49	2.50